成都仕芯半导体有限公司招聘简章
**一、公司简介**

成都仕芯半导体有限公司成立于2017年8月，是一家专业从事射频/微波集成电路芯片,组件和系统解决方案的设计、开发、生产销售的高科技公司，目前已经完成C轮融资。

成都仕芯半导体具有世界一流的专业技术和市场团队，致力于设计、开发、测试和销售高性能射频、微波与毫米波芯片、组件及子系统，并可为雷达、通信、导航、测试与测量等应用领域的客户提供定制式设计服务和射频、微波与毫米波系统解决方案，满足客户的差异化需求。

公司具备深厚的技术积累，所研产品均拥有自主知识产权，并已在国内外申请多项发明专利进行保护。公司获得成都市“准独角兽企业”、成都市企业技术中心、国家级高新技术企业、新经济百家重点培育企业名单等多项荣誉。

公司位于成都高新西区百川路9号（2023年初将搬到成都IC设计产业园，位于成灌高速与天润路、合顺路口，与电子科大清水河校区一路之隔）。

1. **招聘专业方向岗位及人数**

专业方向：集成电路、电磁场与微波等IC设计相关专业。

需求人数：3-5人。

招聘岗位:
**射频模拟ic设计师（应届生或实习生若干）**

**岗位职责**：1、负责射频/微波、毫米波芯片设计，理解并掌握以下芯片(两种及以上)设计：压控振荡器、低噪放、功放、衰减器、移相器、混频器、滤波器等；

2、 负责完成相关产品设计、仿真、验证、调试、联调和问题定位工作；

3、配合完成版图设计和投板工作；

4、完成设计文件的齐套和归档。

**任职要求**：微电子、电磁场与微波技术、无线电物理或相关专业硕士科及以上学历，具有扎实的射频微波基础理论知识，CET4级，具有熟练的英文读写能力。

**薪资福利：根据市场会给到有竞争的薪资和股权激励。(年薪20-40W不等+股权激励)**

**三、公司地点**

成都仕芯半导体将于2023年初搬至成都IC设计产业园（位于成灌高速与天润路、合顺路口）
**联系方式:HR李书莉**15528851928（微信同） **邮箱：**sli2@sicoresemi.com